

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券、上海上柿行、东弘资本、澜胜基金、天瑞万合私募、探骊基金、大橡私募、贵山私募、静山资管、骆驼资本、尚硕资本、杭州附加值投资、中信证券、财联社等机构投资者共计15名
时间	2025年8月14日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务负责人 王韦 董事会秘书 张毅
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍经营情况 二、互动交流问答 1. 公司AI服务器电源的最新进展如何？ 答：在AI服务器、数据中心方向，公司最新进展包括，已量产：数据传输芯片进入量产；应用于AI服务器和AI加速卡的电源管理芯片已实现大规模量产。已通过客户验证：中国首个55nm BCD集成DrMOS芯片通过客户验证。已获得关键客户导入：发布了第二代高效率数据中心专用电源管理芯片制造平台，获得关键客户导入。 2. 公司上半年AI领域的收入占比6%，是否可以介绍下主要的收入来源？ 答：公司AI领域的收入主要来自于三个应用方向，第一，AI服务器、数据中心等；第二，具身智能等；第三，智能驾驶应用方向，如ADAS智能驾驶

	相关的芯片等。 在AI服务器、数据中心等应用方向，公司数据传输芯片进入量产；应用于AI服务器和AI加速卡的电源管理芯片已实现大规模量产；DrMOS 55nm BCD芯片已完成客户验证，下半年进入量产；发布了第二代高效率数据中心专用电源管理芯片制造平台，获得关键客户导入。公司可提供AI服务器电源系统代工方案，服务器电源平台产品覆盖从PSU、IBC及POL的各级供电应用。在具身智能等应用方向，公司的MEMS传感器芯片可应用于语音交互、姿态识别、运动捕捉、机械手抓取与操作、环境感知、导航定位等场景，其中AI眼镜用麦克风芯片、机器人用激光雷达芯片已实现突破。在智能驾驶应用方向，全面扩展MEMS代工服务在车载方向的应用，如ADAS智能驾驶的惯性导航芯片、激光雷达VCSEL芯片、微镜芯片、压力传感器芯片以及智能座舱语音识别麦克风芯片等。 3. 如何看待公司及市场上其他公司不同的经营模式？ 答：各个经营模式均有其不同的特色。 公司创新的“一站式系统代工”的经营模式已获得市场和客户的认可。目前公司在车载、AI服务器电源、具身智能、机器人等领域，均正在实施系统代工模式，比如车灯系统、48V系统、AI服务器高效电源系统等。就公司而言，公司开放的平台模式，可以更好的为客户提供定制化的需求，同时也能更好的接收市场最前沿的需求和技术。 随着公司与终端客户的合作深度和黏性不断加强，车载功率模组批量交付，上半年公司模组封装收入同比增长141%。随着模拟IC代工平台更多量产，公司的系统代工模式，不仅将推动功率模块的增长，还将更多体现在“功率+模拟IC+MCU”集成的全面增长。 4. 请公司介绍下人才激励相关的措施？ 答：公司高度重视人才体系的建设，致力于构建系统化、可持续的人才创新体系。公司近千名员工通过员工持股、期权激励、战略配售以及二类限制性股票等方式直接/间接和公司的股权关联，激励对象覆盖公司的核心技术人员和管理人员。 对于研发人员，除了招揽顶尖人才，公司建立了“应用-设计-工艺”的闭环学习路径；同时公司强调每个工程师的学习，把工程师培养成一个领域、甚至多领域的核心人才。 公司将通过持续的激励计划，不断吸引和留住人才，激励核心骨干力量，增强团队凝聚力和战斗力，为持续创新和高质量发展奠定坚实的人才基础与核心竞争力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2025年8月14日